



『 誠信、守法 』 『 安全、品質 』 『 創新、服務 』

股票代號：3402



漢科系統科技股份有限公司

法 人 說 明 會
Wholetech System Hitech Limited Investor Conference

公司網址：<https://www.wholetech.com.tw>

發言人 / 投資人連絡窗口

姓名：蕭燕啁

傳真：03-5210028

電話：03-5228823 分機1615

Email: novia.hsiao@wholetech.com.tw

漢科系統科技股份有限公司 法 人 說 明 會

Wholetech System Hitech Limited Investor Conference

報 告 人：

主 講 人：謝清泉/總經理

會計主管/發言人：蕭燕啣/財務協理

112/11/23

免 責 聲 明

Disclaimer

The above statements that pertain to future projections constitute the expectations, opinions, outlooks, or predictions of our company and its affiliates based on information available at the time the statements were made. Such statements may be affected by known and unknown risks and inherent uncertainties, the existence of emergence of facts or factors that differ from the assumptions, suppositions, or judgments of the Company, or other factors, Consequently, there may be significant discrepancies between actual results pertaining to the Company's future earnings, management results, financial conditions, and other matters as explicitly or implicitly referred to in the statements and the content of such statements.

The presentation is run exclusively for the purpose of providing information and not for the purpose of soliciting investments or recommending the buying or selling of specific shares or products. Company makes no warranty concerning the accuracy or completeness of the information and will not be liable for any damages arising out of use of the information thereof.

本報告內容係依現有資訊而做成，上述說明中的財務或相關資訊可能包含一些對本公司及其子公司未來前景的說明，這些說明易受重大的風險和不確定因素影響，致使最後結果與原先的說明迥異，是本公司特此聲明，本報告中的內容，僅為資訊流通之目的而公佈，並非投資建議，本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。

目 錄 AGENDA

1. 公司簡介(About WHOLETECH)
2. 營運概況說明 (Operation)
3. 財務狀況說明 (Financials)
4. 業務展望 (Future Prospects)
5. Q&A

公 司 簡 介

About WHOLETECH

公司簡介



股票代號：3402



公司創立



創立日期:1990/07



上櫃日期:2007/01



集團員工人數:650



實收資本額:7億3仟47萬元



領航

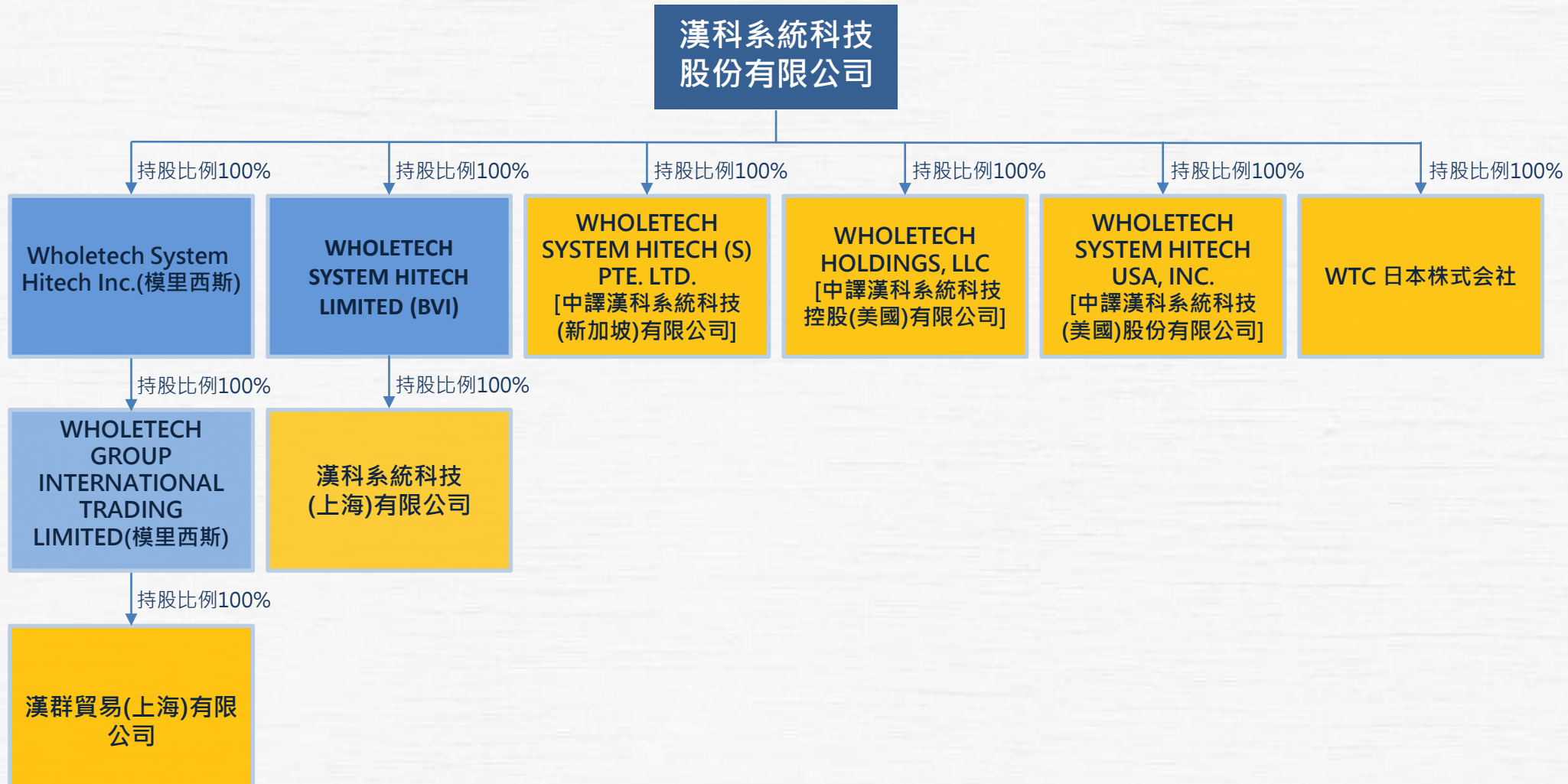


董事長 温永宏

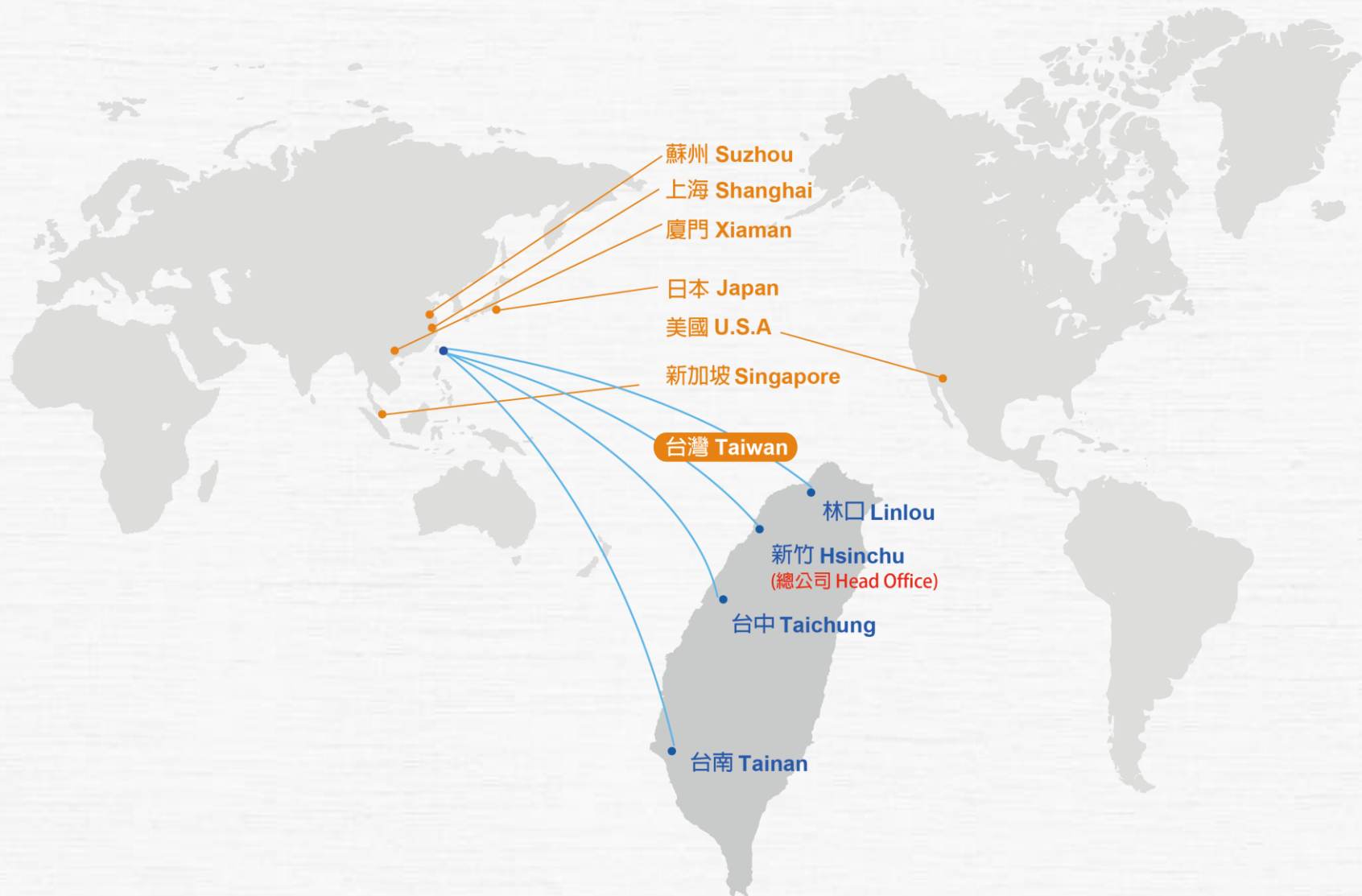


總經理 謝清泉

關係企業組織圖



服務據點



主要業務範圍

漢科團隊的專業技術能力和豐富的工程實務經驗，成立了全方位的系統整合服務平台，現有七大專業事業部門：



W1 氣體 / 特殊管路工程事業部

W2 無塵室 & 機電統包事業部

W3 高真空系統事業部

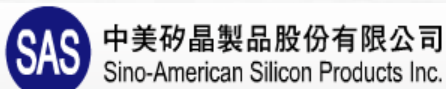
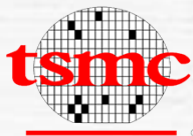
W4 特氣供應 & 監控系統整合事業部

W5 先進產品事業部

W6 系統軟體研發部

W7 濕製程設備 & 化學系統

主要客戶群



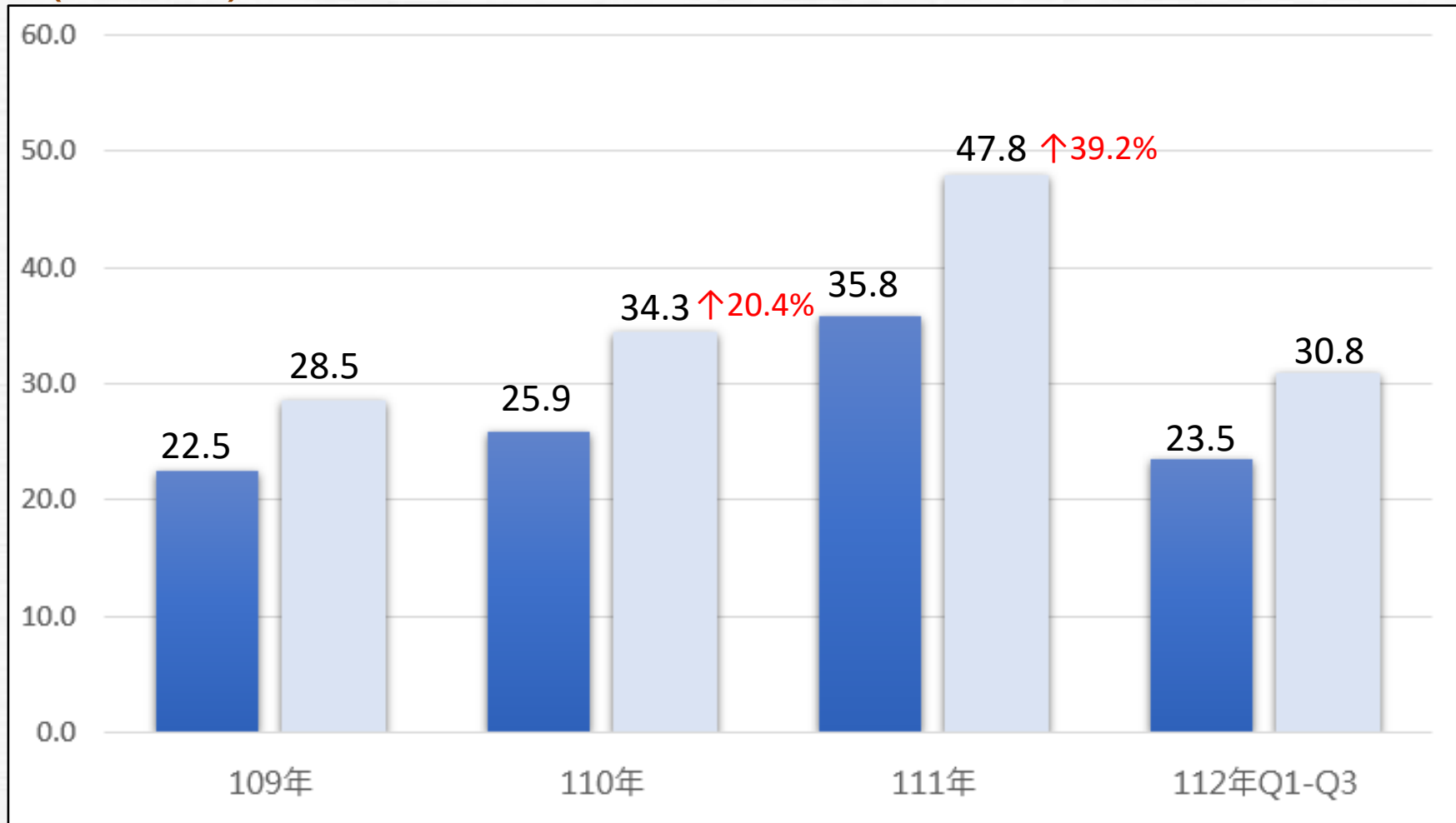
營 運 概 況 說 明

(O p e r a t i o n)

■ 個體營收
■ 合併營收

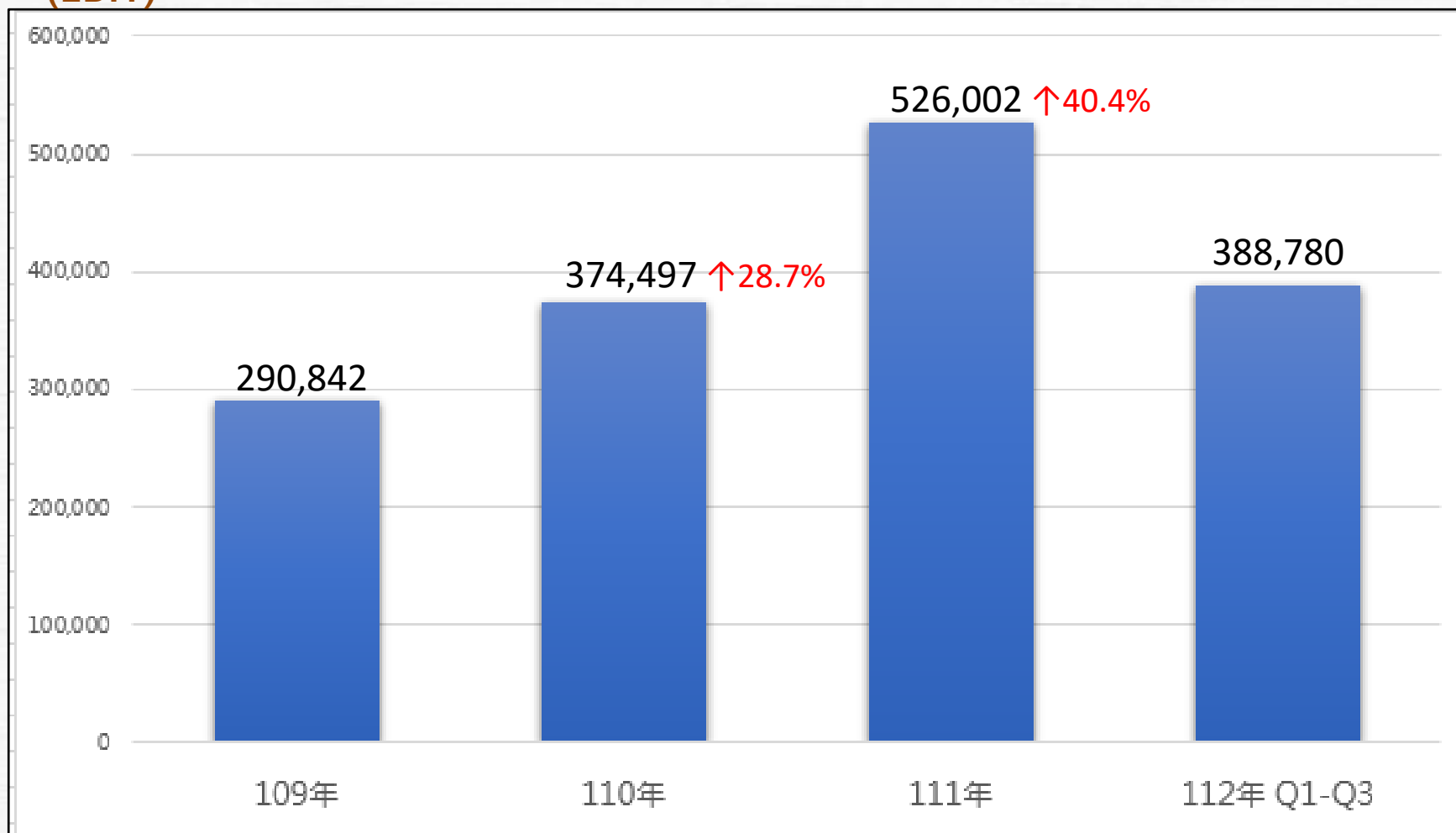
近三年營收 (Revenue)

單位：億元
Unit: NTD 100 million



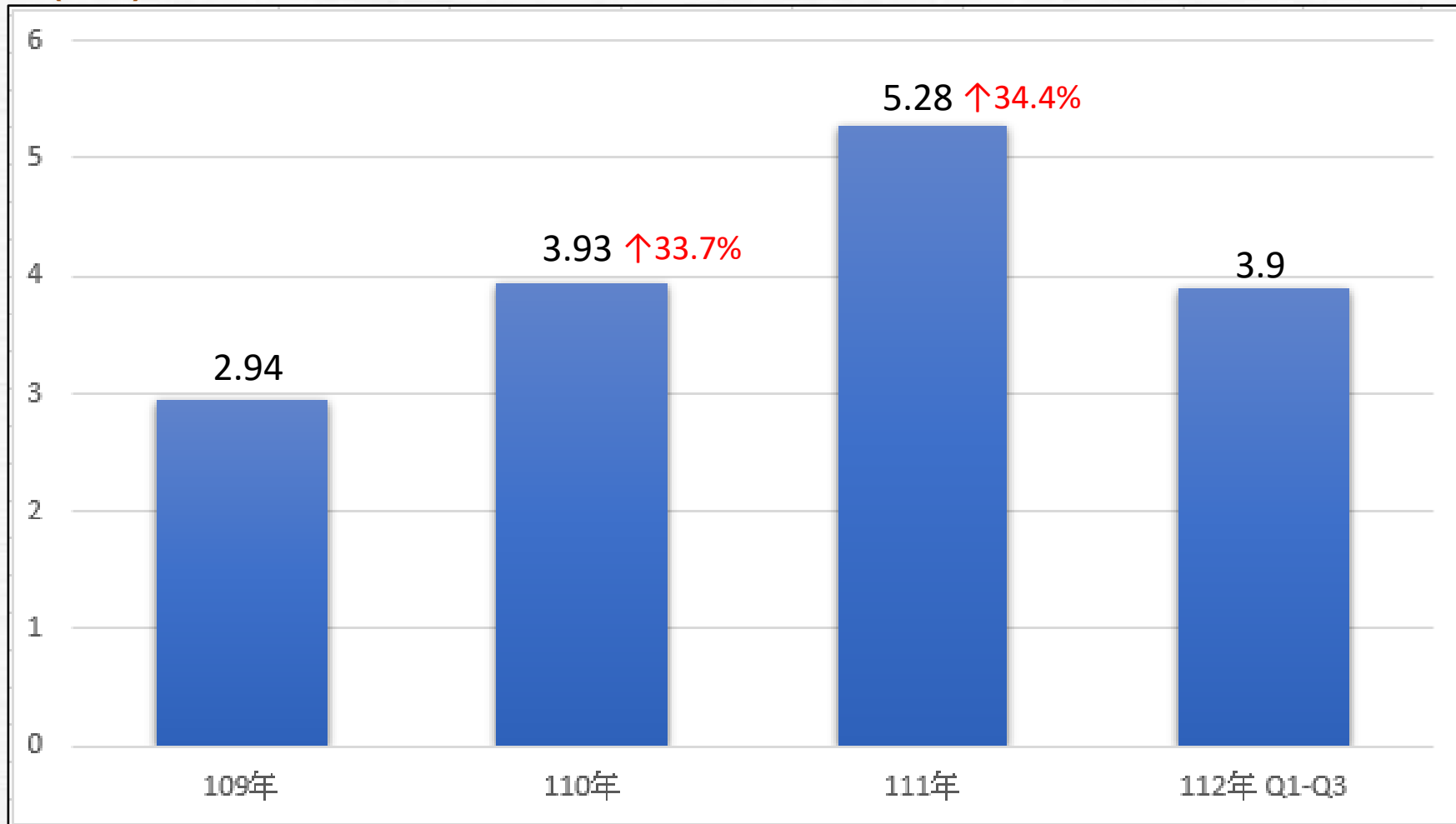
近三年稅前淨利 (EBIT)

單位：仟元
Unit: NTD thousand



近三年每股盈餘 (EPS)

Unit : NTD



近三年盈餘分配狀況 Income Statement

	109年 (2020)	110年 (2021)	111年 (2022)	112年1月1日至9月30日 2023 Jan.~Sep.
營業收入(仟元) Rev.(thousand)	2,847,829	3,431,604	4,777,624	3,077,040
毛利(仟元) Gross Profit(thousand)	525,576	676,883	831,273	656,241
毛利率Gross Profit%	18.46%	19.72%	17.40%	21.33%
本期稅後損益(仟元) EAT(thousand)	211,571	281,194	385,707	284,986
基本每股盈餘(元) EPS	2.94	3.93	5.28	3.9
現金股利(元) Cash Dividends	2.70	3.00	4.20	
股利發放率 Dividend Payout Ratio	91.84%	76.34%	79.55%	
負債占資產比率 Debt Asset Ratio	52.03%	58.24%	71.10%	
流動比率 Current Ration	171.71%	158.45%	129.00%	
純益率 Net Profit Margin	7.43%	8.19%	8.07%	

財 務 狀 況 說 明

(F i n a n c i a l s)

112年合併資產負債表

2023 Q3 Consolidated Balance Sheet

單位：仟元
Unit : NTD thousand

	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日	110年9月30日		112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日	110年9月30日
現金及約當現金 Cash	1,745,785	2,366,004	731,072	948,131	應付帳款 PA	1,476,783	1,766,410	1,807,917	1,544,234
合約資產 - 流動 Contract assets-current	832,294	1,159,533	1,211,105	998,128	合約負債 - 流動 Contract liabilities	1,599,553	1,776,766	1,879,442	192,931
其他流動資產 Others	2,160,321	1,938,040	3,270,027	1,123,305	其他流動負債 Others	481,070	692,309	389,032	248,323
流動資產合計 Total Current Assets	4,738,400	5,463,577	5,212,204	3,069,564	流動負債合計 Total Current Liabilities	3,557,406	4,235,485	4,076,391	1,985,488
不動產、廠房及設備 PPE	682,896	637,163	640,133	446,590	其它非流動負債 Others	169,660	153,383	147,368	133,065
其他非流動資產 Others	73,543	71,940	72,623	78,350					
非流動資產合計 Total Non-current Assets	756,439	709,103	712,756	524,940	負債總計 Total Liabilities	3,727,066	4,388,868	4,223,759	2,118,553
					股東權益總計 Total SE	1,767,773	1,783,812	1,701,201	1,475,951
資產總計 Total Assets	5,494,839	6,172,680	5,924,960	3,594,504	負債及權益總計 Total Liabilities+SE	5,494,839	6,172,680	5,924,960	3,594,504

淨值 24.20元 24.42元 23.29元 20.20元

112年合併損益表

2023 Q3 Consolidated Income Statement

單位：仟元
Unit: NTD thousand

	112年7月1日 至9月30日		111年7月1日 至9月30日		110年7月1日 至9月30日		YOY	112年1月1日 至9月30日		111年1月1日 至9月30日		110年1月1日 至9月30日		YOY
工程收入 Revenue	1,082,376	100%	1,413,748	100%	883,678	100%	22%	3,077,040	100%	3,624,687	100%	2,422,194	100%	27%
工程成本 Cost	845,203	78%	1,180,732	83%	704,397	80%	20%	2,420,799	79%	3,028,203	84%	1,926,406	79%	26%
營業毛利 Gross Profit	237,173	22%	233,016	17%	179,281	20%	32%	656,241	21%	596,484	16%	495,788	21%	32%
營業費用 Operating expenses	115,457	11%	99,328	7%	86,693	10%	33%	354,788	11%	257,416	7%	217,308	9%	63%
營業淨利 Operating Income	121,716	11%	133,688	10%	92,588	10%	31%	301,453	10%	339,068	9%	278,480	12%	8%
營業外收入及支出淨額 Net non-operating income and expenditure	26,294	2%	46,447	3%	4,918	1%	435%	87,327	3%	67,157	2%	7,028	-	1143%
稅前淨利 EBIT	148,010	13%	180,135	13%	97,506	11%	52%	388,780	13%	406,225	11%	285,508	12%	36%
所得稅費用 Income Tax	34,606	3%	46,798	3%	19,952	2%	73%	103,794	4%	112,683	3%	69,044	3%	50%
本期淨利 Net Income	113,404	10%	133,337	10%	77,554	9%	46%	284,986	9%	293,542	8%	216,464	9%	32%
本期淨利歸屬於母公司 Net Income(Parent company)	113,404	10%	133,337	9%	77,554	9%	46%	284,986	9%	293,542	8%	216,464	9%	32%
綜合損益歸屬於母公司 Composite Net Income (Parent Company)	133,162	12%	139,399	10%	76,681	9%	74%	290,761	9%	312,041	9%	206,867	9%	41%
基本每股盈餘 EPS	1.55		1.83		1.08			3.90		4.02		3.03		
稀釋每股盈餘 Diluted EPS	1.54		1.81		1.08			3.85		3.97		2.99		

業 務 展 望

(Future Prospects)

漢科經營策略

專業

深耕高潔淨氣體管路利基市場追求卓越

統包

發展全方位的技術能力，擴大經濟規模，強化競爭優勢

多角化經營

以工程服務三十多年的經驗，支持設備製造的快速成長，建立設備品牌形象，拉大與跟隨者的差距，成為一線廠商的佼佼者

提升競爭力

注重安全與品質，並且與客戶建立長期良好的伙伴關係，嚴格控制成本，授權幹部自主管理，發揮團隊精神

漢科優勢

01

豐富的工程實績

02

內控及財務管理健全

03

自有設計及施工團隊

04

優良品質及安全形象與信譽

05

標準化及客製化設備品牌

06

創新服務模式

漢科自製設備介紹

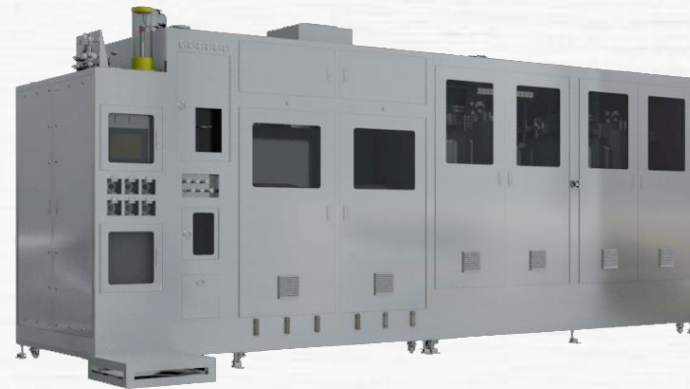
特殊氣體供應設備
Specialty Gas
Supply Unit



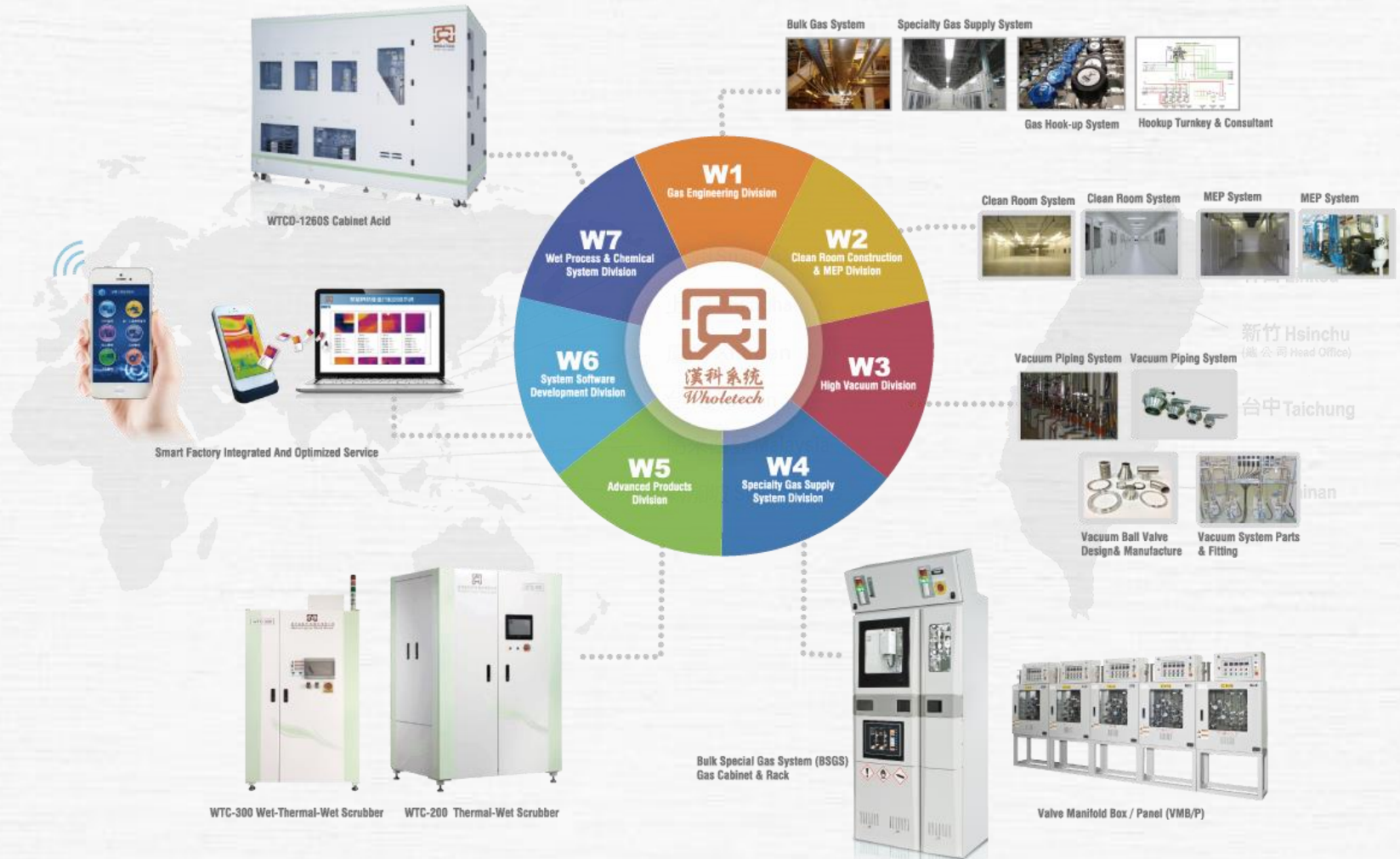
製程尾氣處理設備
Local Scrubber



化學品供應設備
Chemical Supply Unit



漢科全方位系統整合-推動高科技產業全面升級



2024年半導體產業展望

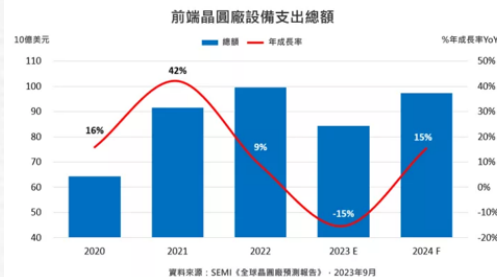
2023年5月-資策會產業情報研究所（MIC）於5月上旬舉行了第36屆MIC FORUM Spring《開聲》研討會：

- 2023年為半導體庫存調整年，推估今年經濟成長模式有可能呈現U型遲緩復甦，景氣循環預估2024年才有望上升
- 數位轉型、永續趨勢持續發酵異質整合封裝與第三類半導體興起
- 5G、HPC、AI、車用、物聯網等應用，將持續推動對半導體元件的長期需求力道



2023年9月- SEMI國際半導體產業協會公布最新一季《全球晶圓廠預測報告》(World Fab Forecast, WFF)指出：

- 受到晶片需求疲軟以及消費性產品、行動裝置庫存增加影響，預估全球晶圓廠設備支出總額將先蹲後跳，從2022年的歷史高點995億美元下滑15%至840億美元；隨後於2024年回升15%，達到970億美元。
- 2024年的晶圓廠設備支出復甦將可望在半導體庫存調整結束，以及高效能運算(HPC)、記憶體等需求增加而有所提升。



展望2024年晶圓廠設備支出

區域	支出金額 (億美元)	年增減幅 (%)
台灣	249	4.2
韓國	210	41.5
中國	160	持平
美洲	110	23.9
歐洲及中東	82	36.0
全球半導體設備市場	920	21.0

資料來源: SEMI 製表: 蘇嘉維

資料來源: SEMI《全球晶圓廠預測報告》整理，2023年9月

資料來源: WSTS、Tesla、Dreamstime、Google、Delta、MIC整理，2023年5月

國安戰略型(半導體)：海外設廠，鞏固與策略夥伴關係

- 驅動因素**
- 美中競局、俄烏戰爭等變數影響，地緣政治成為廠商布局重要考量，為滿足各國政府國家安全、客戶資訊安全要求，產業進行在地化布局，使各國具一定自主性
- 供應鏈布局變化**
- 臺灣仍為主要研發與生產基地，但轉移部分產能至策略性國家，強化供應鏈夥伴關係，同時為滿足自主性要求，將帶動上下游供應鏈一起移動
 - 案例-半導體：臺灣為高階先進製程及研發中心，為了穩固與國際策略夥伴關係，臺廠前往美國、日本等國建設晶圓廠



產業科技國際策略發展所 資料來源: 工研院產科國際所

工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

資料來源: 工研院產科國際所

半導體產業展望

項目	說明
全世界半導體市場規模	<ul style="list-style-type: none"> ● 2023年將年減13.1%至5,188億美元，2024年將年增20.7%，至6,259億美元 ● 2032年半導體產業市值將達到1兆美元
科技新應用 (2022~2027年)	<ul style="list-style-type: none"> ● AI年均複合成長率是14% ● 車用年均複合成長率為9% ● 工業年均複合成長率是8% ● 資料中心年均複合成長率是6%

資料來源: IDC

製表: 李娟萍

資料來源: 工商時報

業 務 展 望

2023年為半導體庫存調整年，部分客戶建廠速度放緩，經濟成長呈現U型遲緩復甦，但總體市場規模仍具龐大商機。漢科靠著全方位的技術能力，推動整廠輸出模式營運，2023年仍接獲許多擴廠訂單，且設立了日本及美國子公司，超前佈局強化在地化動能。

2024年隨著庫存逐步消化、通膨趨緩；國際供應鏈重組、5G及AI產業上升趨勢，各大廠陸續至歐美日建廠，外需大幅提升。漢科具全方位技術能力，將持續積極配合客戶的投資計劃服務客戶，秉持專業且全方位系統整合的經營策略，不斷提升漢科優勢，堅持『誠信、守法』『安全、品質』『創新、服務』的經營理念，2024年亮麗業績仍可期待。



www.wholetech.com.tw

漢科系統科技股份有限公司

